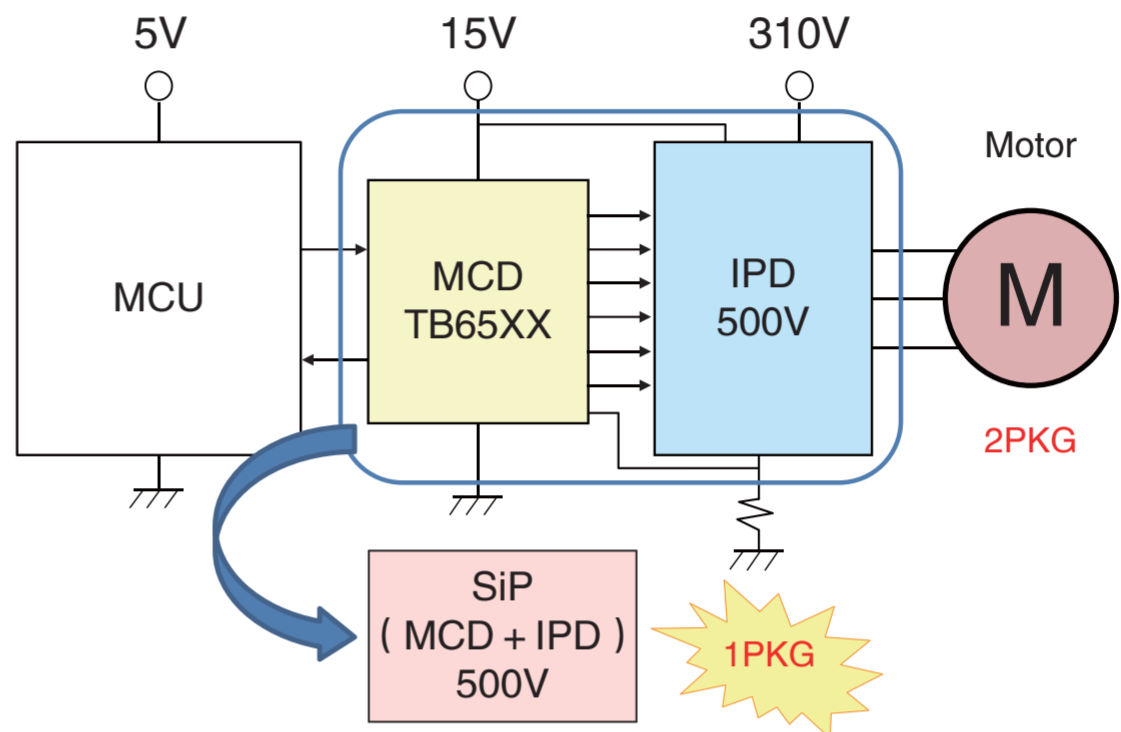


TB67B000系列产品

500V / 2A高压正弦波三相直流无刷驱动

客户价值定位

- SiP: 控制器 + 功率模块
 - 更小封装和更小安装面积
 - 简化PCB设计
- 180° / 150°驱动可选择
 - 低噪声
 - 高效率



TB67B000FG特点

- 支持回流焊焊接
- 减小安装面积53% (对比HDIP30)
- HSSOP34封装散热性能与HDIP30大封装基本一致

IC封装信息

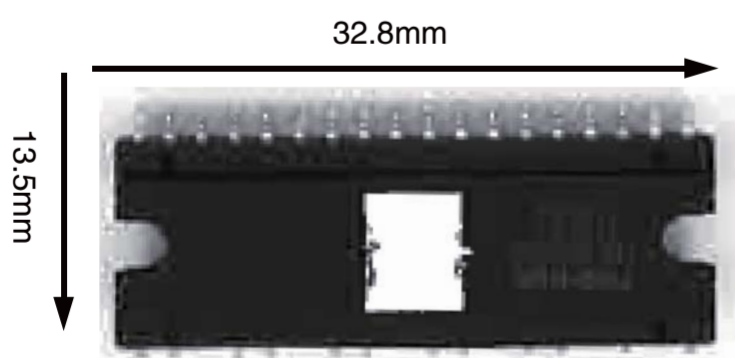
封装 (产品名称)	HSSOP34 (TB67B000FG)	HDIP30 (TB67B000HG)	
尺寸	17.5 × 11.93mm	32.8 × 13.5mm	减小53%
安装面积	209mm ²	443mm ²	
管脚数	34pin	30pin	
管脚间距	0.8mm	1.778mm	
管脚距离 (高压部分)	2.4mm	3.556mm	
Rθja [°C/W]* (仿真数据)	16.2	16.1	参数相同
IC安装方式	Reflow	Folw	

*: 仿真条件: 控制板位于电机内部
PCB: FR-4, Φ92mm, 2-layer
电机: 铝制端盖

应用

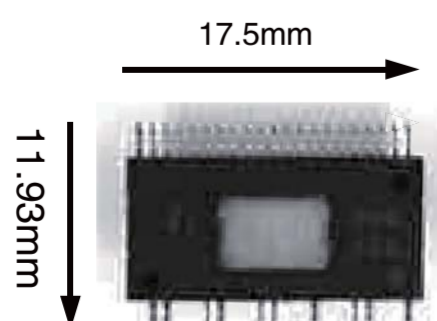
- 空调器风扇
- 高压风扇

TB67B000HG (2015年批量)



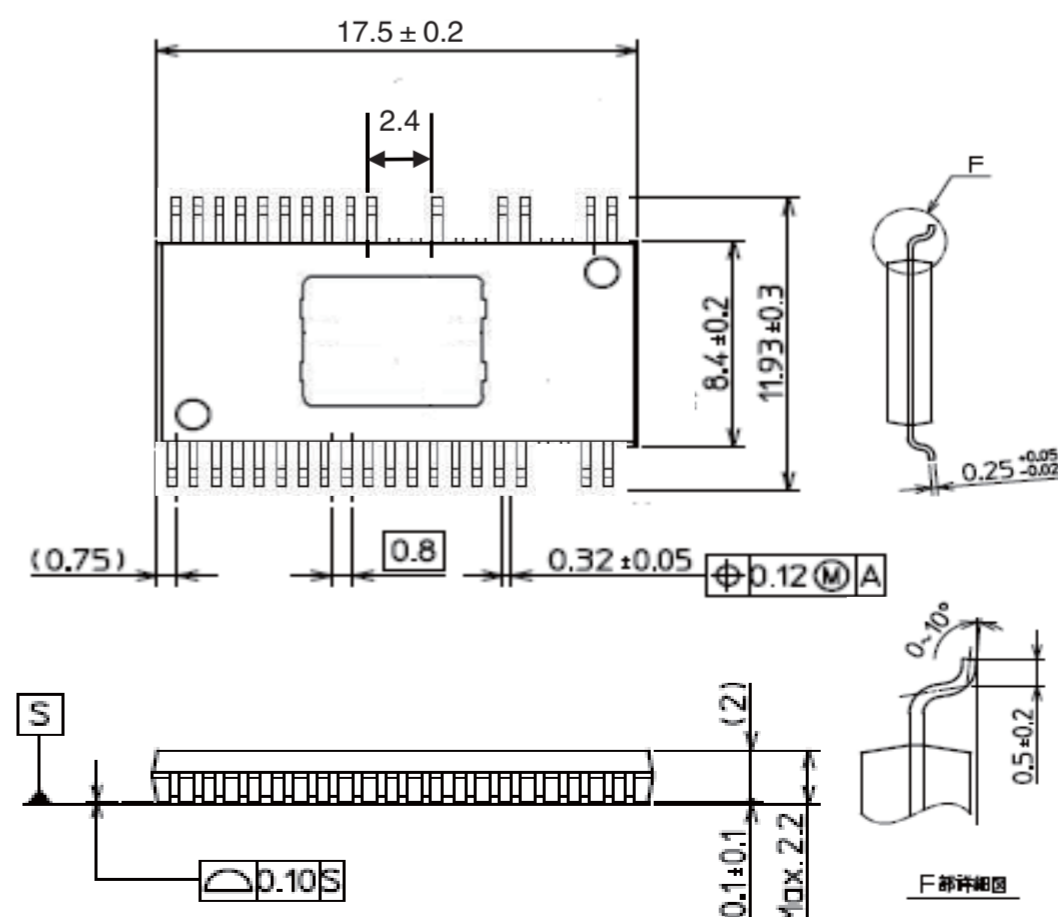
HDIP30

TB67B000FG (新产品)



HSSOP34

HSSOP34封装尺寸



以上信息如有变更恕不另行通知。

